

Minimaalne pime ava

Pime ava (blind via) on trükkplaati mitteläbiv ühendus, mida luuakse välis- ja sisekihtide vahel. Ebapiisava kuvasuhte puhul (puuri läbimõõt peenem kui ava sügavus) kasutatakse ka pimedate avade üksteise otsa ladumist, nn korrusavasid (stacked vias).

Brandner Electronics OÜ-s, nagu ka enamikes Jaapani trükkplaadifirmades, kasutatakse pimedate avade mehaanilist valmistamist, mis garanteerib avade kõrgema kvaliteedi kui lasertehnoloogia.

Minimaalne mõõt näitab puuritera diameetrit, millega ava puuritakse. Peale metallisatsiooni kahaneb pimedate ava läbimõõt kuni 50µ võrra.



Läbilõiked ehk mikrolihvid erineva läbimõõduga pimedatest avadest.